

证券代码：301338

证券简称：凯格精机

东莞市凯格精机股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话/网络会议
参与单位名称及人员姓名	东吴基金、华安基金、金信基金、景熙资产、登程资产、双安资产、上海盛宇、天风证券、财通证券、东北证券、广发证券、国金证券、国泰君安、国元证券、华安证券、华福证券、民生证券、首创证券、西南证券、中金公司、中泰证券、中信建投、中邮证券等 25 位投资者。
时间	2024 年 08 月 30 日 10:00-11:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 邱靖琳 证券事务代表 刘丹 投关经理 江正才
投资者关系活动主要内容介绍	公司基本情况介绍： 董秘邱靖琳女士详细介绍了公司 2024 年半年度主营业务情况。 公司与参会人员就以下问题进行了探讨： <b>1、请分板块介绍公司业务营收情况？</b> 答：报告期内，公司实现营业收入 35,939.14 万元，同比增长 25.05%；从营收结构来看，锡膏印刷设备实现营业收入

19,014.68 万元，同比下降 6.38%；封装设备实现营业收入 9,676.97 万元，同比增长 297.96%；点胶设备实现营业收入 4,789.72 万元，同比增长 72.04%；柔性自动化设备实现营业收入 1,430.70 万元，同比下降 41.23%。

## **2、 针对于公司毛利率下滑，公司采取了哪些措施？**

答：公司营收占比较高的业务毛利率均有一定的增长，但产品销售结构变化导致综合毛利率有所下降。报告期内，公司综合毛利率为 32.29%，同比小幅下降 3.97 个百分点，主要受到公司产品销售结构变化的影响，毛利率较低的封装设备增长较快，营收占比提升较多。营收占比较高的业务毛利率均有一定的增长，锡膏印刷设备毛利率同比上升 1.34 个百分点，封装设备毛利率同比上升 3.63 个百分点。

公司将继续优化产品，迭代升级产品性能，保持产品市场地位和竞争力，同时通过技术创新、供应链的管理和市场细分领域的深耕以期提高产品毛利率。

## **3、 点胶机营收增长的主要原因是什么？**

答：报告期内，点胶设备实现营业收入 4,789.72 万元，同比增长 72.04%。主要系技术的沉淀、产品的升级增强了点胶设备的核心竞争力，公司充分发挥在电子装联行业的品牌影响力及客户协同效应，市场占有率得到稳步提升。

## **4、 封装设备板块爆发式增长的原因？**

答：公司封装设备下游以 LED 照明、显示为主，中游 LED 封装企业具有降本增效和产能升级的需要，通过替换和新增设备，实现效率提升和产能升级。公司 LED 封装设备经过多年的技术沉淀，逐步获得 LED 封装头部企业的认可，产

品营业收入同步增长 297.96%。

在传统 LED 固晶机出货量取得突破之后，继续推进产品优化及供应链降本增效，扩大交付边际效应，提升产品毛利率，报告期内，毛利率同比上升 3.63 个百分点。

**5、公司在手订单情况如何？**

答：公司在手订单充足，报告期末，合同负债为 8,849.23 万元，较上期末增长 64.95%；发出商品 35,313.47 万元，较上期末增长 23.42%。

**6、公司认为下游有回暖的趋势吗？**

答：2024 年上半年，以智能手机为代表的终端市场有复苏的迹象，导致下游企业设备投资有一定的回暖。根据 Canalys 数据，2024 年第二季度全球智能手机出货量连续三个季度增长，出货量同比增长 12%。

**7、公司海外布局的情况是怎么样的？**

答：公司的海外策略是一个多方位、多层次的国际化布局，旨在通过跟随现有客户、深化海外子公司的本地化运营、灵活应对市场变化以及积极参与国际交流，来实现全球市场的持续增长和品牌影响力的提升。

**8、能否简要介绍公司的研发布局**

答：一直以来，公司坚持“好的产品是设计出来的”研发理念，坚定落实公司“共享技术平台+多产品+多领域”的研发布局，实现公司产品从单个“单项冠军”迈向多个“单项冠军”的战略。研发团队以项目为主导，以客户需求为基础，将各个事业部的产品方向从 SMT 向泛半导体 COB 及半导体封装领域衍生。比如，公司面向半导体行业推出 Climber

	<p>系列产品；锡膏印刷设备-<b>PLED-mini</b> 可满足 COB Mini LED 的印刷要求；<b>Gsemi</b> 植球设备可满足半导体封装领域晶圆植球的要求；点胶设备-<b>D-semi</b> 可满足半导体领域点胶点锡、底部填充、<b>BGA</b> 焊球强化工艺要求。</p> <p><b>9、公司锡膏印刷设备的竞争力如何？</b></p> <p>答：公司的锡膏印刷设备技术能力处于国内领先、国际先进水平。公司锡膏印刷设备可较好地解决印刷过程中面临的复杂问题，为客户提供一整套锡膏印刷解决方案。</p> <p>锡膏印刷设备对于整个 SMT 产线的重要性很高，电子产品 SMT 组装过程中大概 60-70%的焊接缺陷是由于锡膏印刷不良引起的，所以下游大客户会非常谨慎地选择锡膏印刷设备的供应商。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 8 月 30 日